

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2022年3月3日(03.03.2022)



(10) 国際公開番号

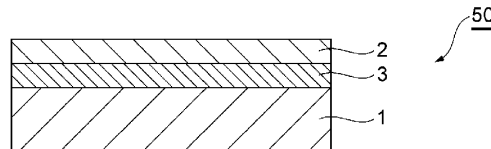
WO 2022/044919 A1

- (51) 国際特許分類:
B65D 65/02 (2006.01) *B65D 75/34* (2006.01)
B32B 27/28 (2006.01) *B65D 85/86* (2006.01)
B32B 27/30 (2006.01)
- (21) 国際出願番号: PCT/JP2021/030211
- (22) 国際出願日: 2021年8月18日(18.08.2021)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (30) 優先権データ:
特願 2020-140976 2020年8月24日(24.08.2020) JP
- (71) 出願人: デンカ株式会社 (DENKA COMPANY LIMITED) [JP/JP]; 〒1038338 東京都中央区日本橋室町二丁目1番1号 Tokyo (JP).
- (72) 発明者: 中島 剛介 (NAKAJIMA Gosuke); 〒1038338 東京都中央区日本橋室町二丁目1番1号 デンカ株式会社内 Tokyo (JP). 名波 圭祐 (NABA Keisuke); 〒1038338 東京都中央区日本橋室町二丁目1番1号 デンカ株式会社内 Tokyo (JP). 阿津坂 高範 (ATSUSAKA Takanori); 〒1038338 東京都中央区日本橋室町二丁目1番1号 デンカ株式会社内 Tokyo (JP). 徳永 久次 (TOKUNAGA Hisatsugu); 〒1038338 東京都中央区日本橋室町二丁目1番1号 デンカ株式会社内 Tokyo (JP).
- (74) 代理人: 長谷川 芳樹, 外 (HASEGAWA Yoshiaki et al.); 〒1000005 東京都千代田区丸の内二丁目1番1号丸の内 M Y P L A Z A

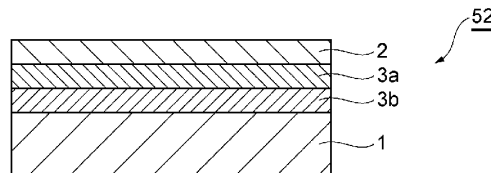
(54) Title: COVER TAPE AND ELECTRONIC COMPONENT PACKAGE

(54) 発明の名称: カバーテープ及び電子部品包装体

(a)



(b)



(57) Abstract: This cover tape has at least a base material layer and a heat seal layer, wherein the heat seal layer contains a polystyrene-based resin (A) and an ethylene-(meth)acrylic acid copolymer (B), and the content of component (A) and the content of component (B) are, respectively, greater than 80 parts by mass but less than or equal to 95 parts by mass, and greater than or equal to 5 parts by mass but less than 20 parts by mass, with respect to a total of 100 parts by mass of component (A) and component (B).

[続葉有]

(明治安田生命ビル) 9階 創英国際特
許法律事務所 Tokyo (JP).

- (81) 指定国(表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IR, IS, IT, JO, JP, KE, KG, KH, KN, KP, KR, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, WS, ZA, ZM, ZW.
- (84) 指定国(表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

- 国際調査報告 (条約第21条(3))

(57) 要約: カバーテープは、基材層と、ヒートシール層と、を少なくとも有し、ヒートシール層が、ポリスチレン系樹脂 (A) 及びエチレンー (メタ) アクリル酸系共重合体 (B) を含有し、(A) 成分及び (B) 成分の含有量がそれぞれ、(A) 成分及び (B) 成分の合計 100 質量部に対して、80 質量部超 95 質量部以下及び 5 質量部以上 20 質量部未満である。